

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-50

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	招商证券、南方基金、信达澳亚基金、景顺长城基金、长城基金
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年8月29日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 2024 年半年度经营业绩情况。</b></p> <p>2024 年上半年，电子产业受益于 AI 带来的算力需求爆发以及周期性的库存回补，需求略有修复。报告期内，公司实现营业总收入 83.21 亿元，同比增长 37.91%，归母净利润 9.87 亿元，同比增长 108.32%。上述变动主要得益于公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，三项主营业务收入均实现同比增长。同时由于 AI 的加速演进及应用深化，叠加汽车电动化/智能化趋势延续，以及服务器总体需求回温等因素，推动公司产品结构优化，助益利润同比提升。</p> <p><b>Q2、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务产品下游应用分布变化情况。</b></p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。报告期内，公司 PCB 业务在数据中心及汽车电子领域占比较去年同期有</p>

所提升。

**Q3、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在通信领域经营拓展情况。**

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年上半年，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求在 AI 相关需求的带动下有所增长，助益公司通信领域 PCB 产品结构优化，盈利能力有所改善。

**Q4、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在数据中心领域经营拓展情况。**

数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年上半年，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 EGS 平台迭代升级，服务器总体需求回温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、EGS 平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。

**Q5、请介绍公司 2024 年上半年 PCB 业务在汽车电子领域经营拓展情况。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内 Tier1 客户，以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向。2024 年上半年，公司 PCB 业务在汽车电子领域继续重点把握上述方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，智能驾驶相关高端产品需求稳步增长，推动汽车电子领域业务占比提升。

**Q6、请介绍公司 2024 年上半年封装基板业务在下游市场拓展情况。**

2024 年上半年，公司封装基板业务 BT 类产品紧抓市场局部需求修复机会，并加快新产品和新客户导入，推动订单较去年同期明显增长，需求整体延续去年第四季度态势；FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

**Q7、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。**

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时将继续

	<p>引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p> <p><b>Q8、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</b></p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。</p> <p><b>Q9、请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较二季度变化情况。</b></p> <p>公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第二季度基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p><b>Q10、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。</b></p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024 年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末有所上浮，整体保持平稳，未对公司 2024 年上半年度经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p><b>Q11、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。</b></p> <p>公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前其基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 8 月 29 日</p>